

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成18年12月21日(2006.12.21)

【公開番号】特開2004-207690(P2004-207690A)

【公開日】平成16年7月22日(2004.7.22)

【年通号数】公開・登録公報2004-028

【出願番号】特願2003-377024(P2003-377024)

【国際特許分類】

H 05 K 7/20 (2006.01)

F 28 F 3/04 (2006.01)

H 01 L 23/373 (2006.01)

【F I】

H 05 K 7/20 B

F 28 F 3/04 Z

H 01 L 23/36 M

【手続補正書】

【提出日】平成18年11月1日(2006.11.1)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0003

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0003】

ところで、近年、前記コンピュータ等の電子機器では、よりコンパクトで軽量な製品が好まれる傾向にあり、そのためにはヒートシンクやヒートシンクを使用した熱交換器の小型化や軽量化が重要な課題となり、しかも小型で軽量であっても高い熱交換性能を持つものが要求されるようになった。

【特許文献1】特開2002-1511号公報

【特許文献2】特開2002-64170号公報

【特許文献3】特開2002-190558号公報

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0033

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0033】

【表2】

樹脂名	記号	グレード	荷重たわみ温度	連続使用温度 (電気的)	融点 °C
			0.45MPa °C	1.82MPa °C	
モノマー・キヤストナイロン	PA	耐熱性	>215	>200	150 200
ポリアミドイミド	PAI	N ガラス充填 摺動性	— —	278 271 278	250 260 250 —
ポリベンズイミダゾール	PBI	N	—	435	345 —
ポリエーテルエーテルケトン	PEEK	N GF30% 摺動性 導電性	— — —	155 230 195 230	250 250 250 250 340 334 340 340
ポリエーテルイミド	PEI	N GF30%	210 212	200 210	170 170 —
ポリエーテルサルボン	PES	N GF30%	210 —	203 216	180 180 —
ポリイミド	PI	N	—	360	304 —
ポリフエニレンサルファイド	PPS	N GF40%	—	121 260	220 220 282 278
ポリサルファン	PSU	GF30%	190	185	160 —
ポリテトラフルオロエチレン	PTFE		121	55	260 327
テトラフルオロエチレン-ハーフオロアルキルカク	PFA		74	47	260 310
フルオロエチレン-プロピレン	FEP		72	50	200 275
ポリクロロトリフルオロエチレン	PCTFE		126	—	177~220 220
テトラフルオロエチレン-エチレン	ETFE		104	74	150~180 270
エチレンクロロトリフルオロエチレン	ECTFE		116	77	165~180 220~245